


回流焊



再流焊



学生了 再流 接工 ,
接方式, 工 特 以及 温曲



接方式 温曲



温曲

再流焊工艺流程

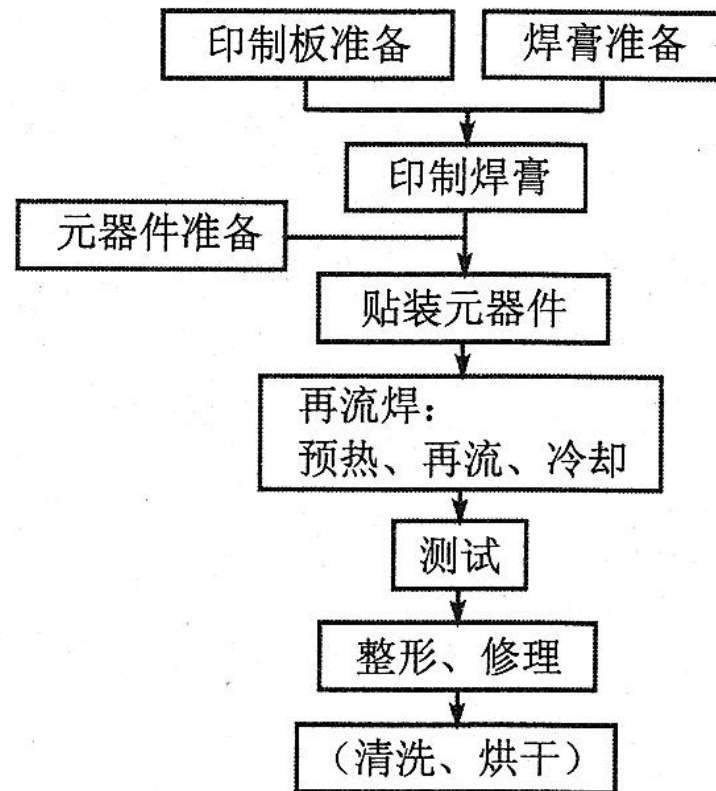


图 8-1 再流焊技术的一般工艺流程

名称 MODEL	TPD. T962H8.
-------------	--------------

- ◆ 作业条件:
1. 程式名称: TPD. T962H8. PB7
 2. 炉温曲线规格: 参照右图1

- ◆ 设备/治工具:
1. 回焊炉: NS-1000 II-N
 2. 炉温测试仪: KIC
 3. Profile 测温板

- ◆ 作业步骤:
1. 按<<回焊炉操作指导书>>开
 2. 调出程序检查温度设定值是
 3. 调整轨道宽度,使轨道宽度约
 4. 炉温测试技术员根据条件设定
 5. 产线正常流板生产,每块PCB之

- ◆ 注意事项 (NOTICE):
1. 作业员必须佩戴有线静电环/
 2. 机台温度全部显示绿色时方可
 3. 作业时禁止碰及回焊炉链条及
 4. 每班交接班及切换机种时测试
 5. 制程异常需要更改炉温时,需
 6. 机器温度超过±5℃会自动报



炉温曲线规格:

150°C - 200°C - 250°C - 260°C - 250°C - 200°C - 150°C

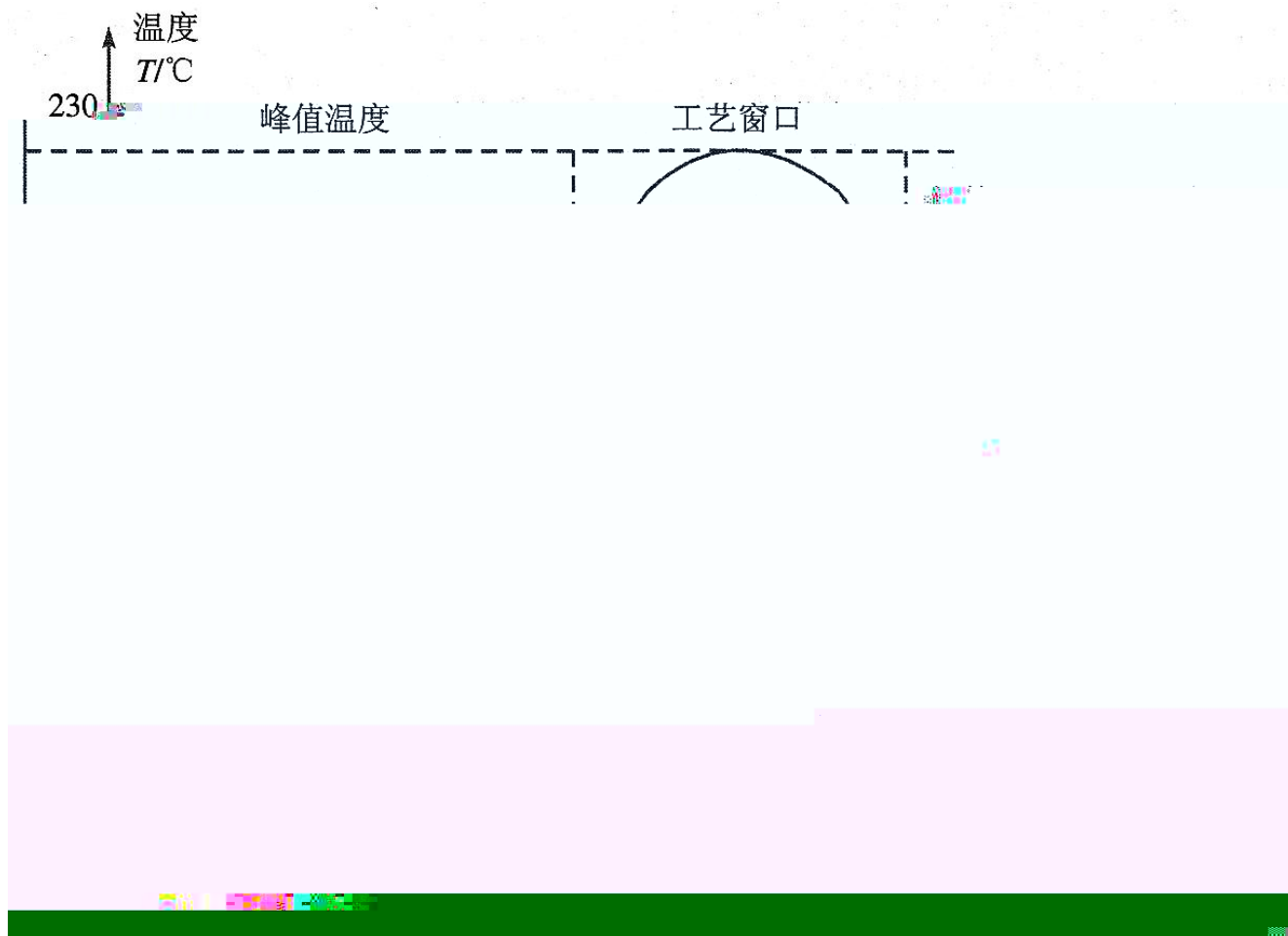
0.00 min - 0.50 min - 1.00 min - 1.50 min - 2.00 min - 2.50 min - 3.00 min

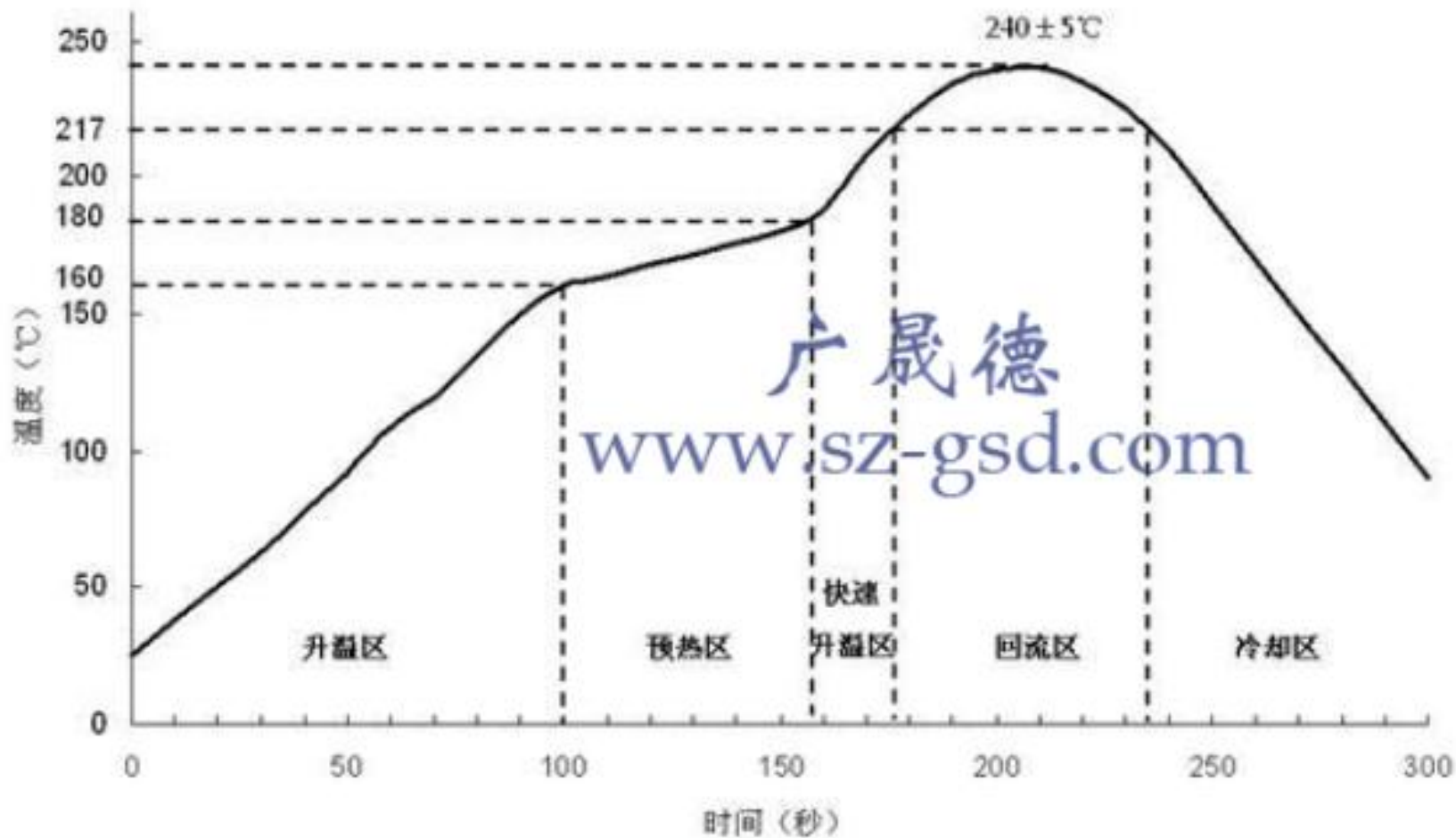
炉温测试:

150°C - 200°C - 250°C - 260°C - 250°C - 200°C - 150°C

0.00 min - 0.50 min - 1.00 min - 1.50 min - 2.00 min - 2.50 min - 3.00 min







再流焊的工艺要求

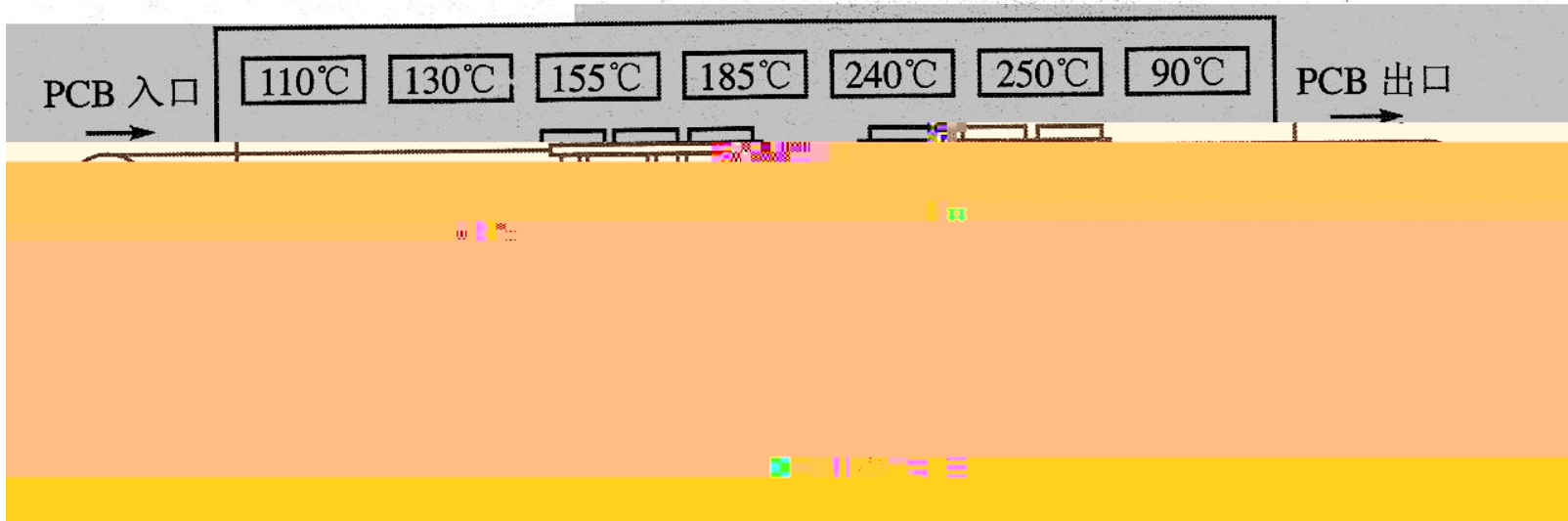
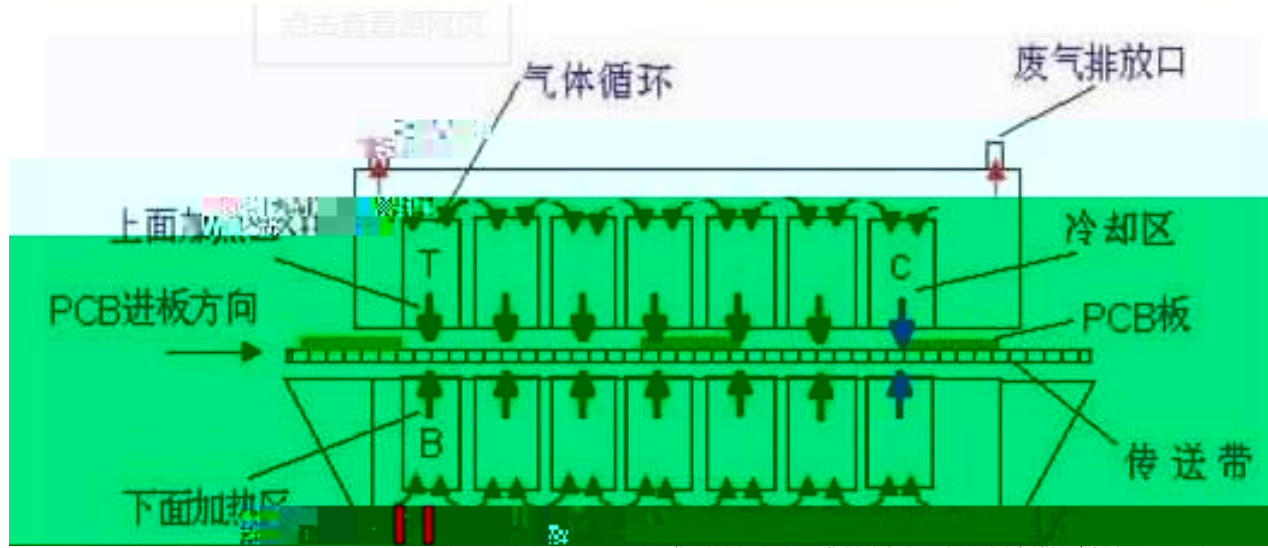
(1) 要设置合理的温度曲线。

(2) SMT电路板在设计时就要确定焊接方向，并应当按照设计方向进行焊接。

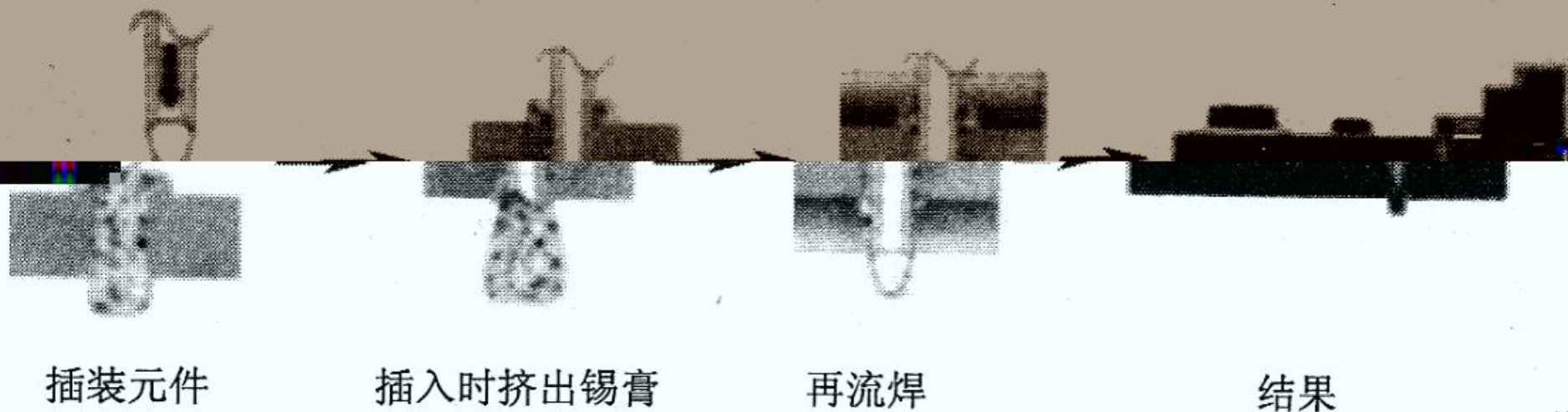
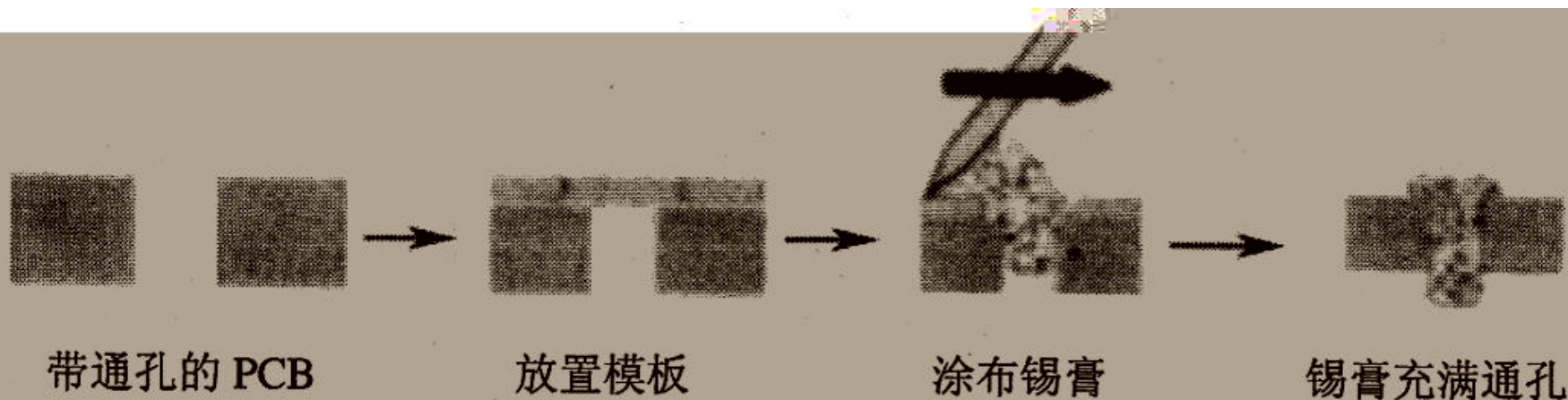
(3) 在焊接过程中，要严格防止传送带振动。







通孔元件和贴装元件在同一侧



加热方式		原 理	优 点	缺 点
件	汽相	利用惰性溶剂的蒸汽凝聚时释放的潜热加热	<ul style="list-style-type: none"> ① 加热均匀，热冲击小 ② 升温快，温度控制准确 ③ 在无氧环境下焊接，氧化少 	<ul style="list-style-type: none"> ① 设备和介质费用高 ② 不利于环保
	热板	利用热板的热传导加热	<ul style="list-style-type: none"> ① 减少对元器件的热冲击 ② 设备结构简单，操作方便，价格低 	<ul style="list-style-type: none"> ① 基板热传导性能影响大 ② 不适用于大型基板、大型元器件 ③ 温度分布不均匀

工作适应性

